



株式会社シキノハイテック

2026年3月期 第2四半期 決算説明資料

東証スタンダード 証券コード：6614

2025年11月14日

売上高は前年同期比で微増となるも利益は伴わず減益

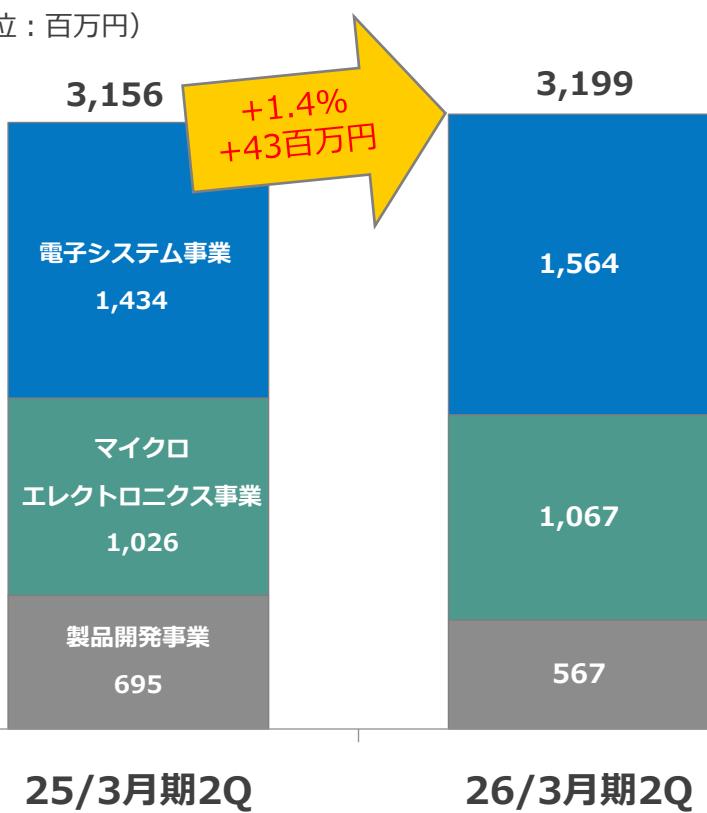
- 第2四半期の売上高は、製品開発事業で前年同期比減収となったが、電子システム事業及びマイクロエレクトロニクス事業では増収となり、全社ベースでも微増。
- 利益は、前年同期比で電子システム事業、マイクロエレクトロニクス事業、製品開発事業の3事業共に営業利益・経常利益ともにマイナス。
- 2Q期間中に政策保有株式を売却し、特別利益が32百万円計上されマイナス幅は縮小も当期純利益は損失計上。
- 通期予想に対する進捗は売上高、利益共に予想を若干下回る実績で推移。

(単位：百万円、%)

	2026/3期 通期予想		2026/3期 2Q実績 (累計)		通期予想比	前年同期比	
	金額	構成比	金額	構成比		進捗率	増減率
売 上 高	7,006	100.0	3,199	100.0	45.7	1.4	43
販 管 費	1,189	17.0	574	17.9	48.3	△7.8	△48
営 業 利 益	136	1.9	△102	△3.2	-	-	△126
営 業 利 益 率	1.9		△3.2		-	-	
経 常 利 益	130	1.9	△104	△3.3	-	-	△126
当 期 純 利 益	100	1.4	△50	△1.6	-	-	△68

前年同期比で43百万円增收

(単位：百万円)



電子システム事業

- 自動車市況の不透明感により車載用専用計測器の受注が大幅に減少、カスタムバーイン装置や非車載用計測機器の受注は増加し130百万円の增收

マイクロエレクトロニクス事業

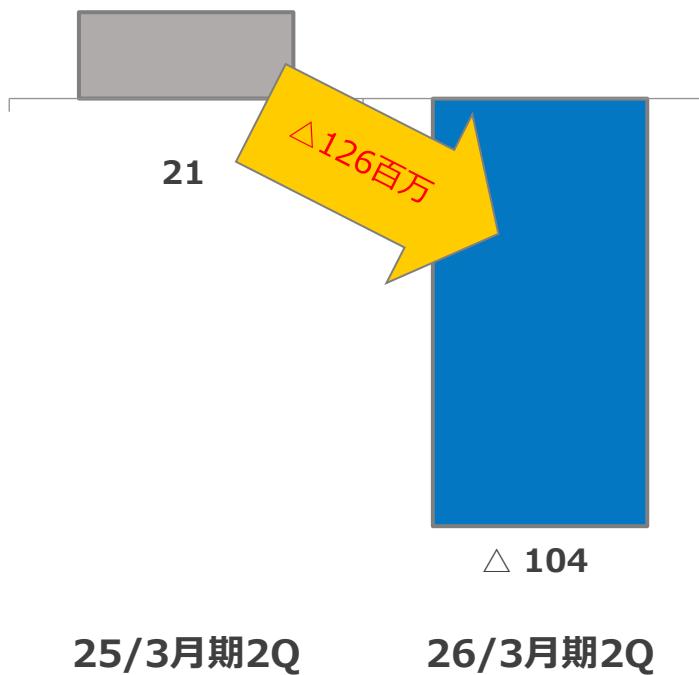
- 車載向けアナログLSI設計や海外顧客の設計は堅調で40百万円の增收

製品開発事業

- 海外向けATMやドローン向け製品は増加も国内ATMやセルフレジカメラの受注が減少127百万円の減収

前年同期比で126百万円減益

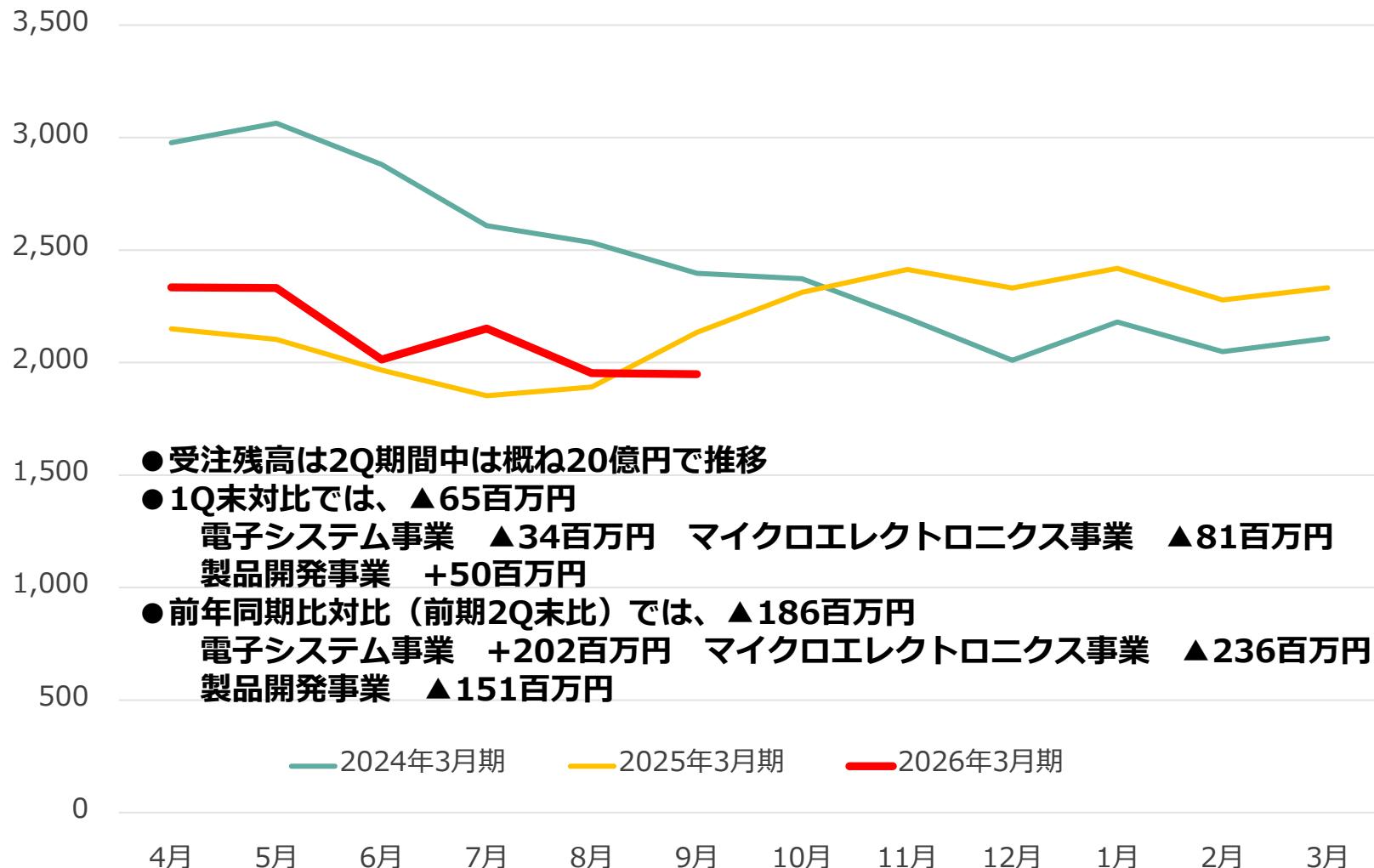
(単位：百万円)

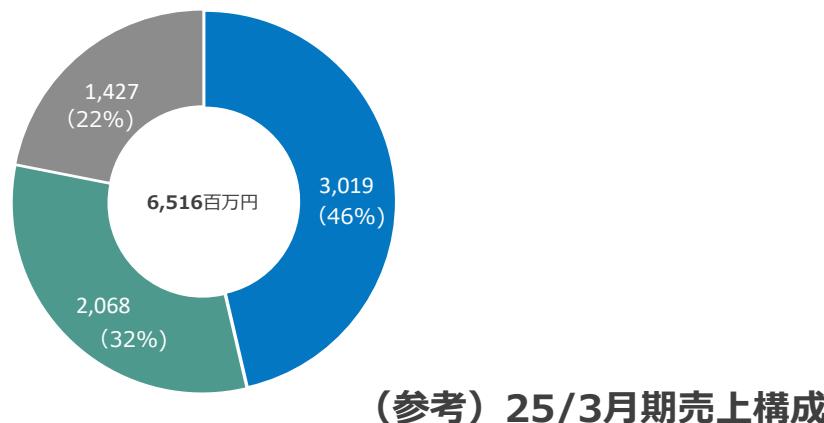
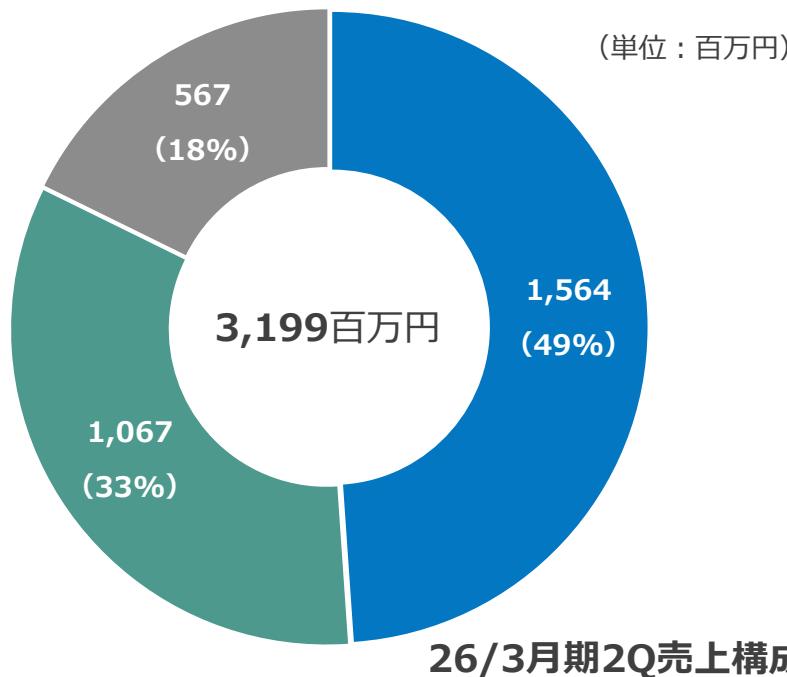


- ・電子システム事業で半導体信頼性商品の構成変化や一部商品が開発から製造へ移行した事で資材費率が上昇
- ・マイクロエレクトロニクス事業で労務費が増加
- ・製品開発事業が減収
- ・前年 1Qでは発生がなかった新基幹システムの償却費差分が発生
- ・研究開発費は重点テーマに絞り支出を抑えた事から販管費は減少

【受注残高（全社）】

(単位：百万円)





電子システム事業

半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、高速通信機器、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、電子機器の開発・設計・製造

マイクロエレクトロニクス事業

LSI設計（アナログ・デジタル）、IPコア

電源IC設計、高速I/F設計、イメージセンサ設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計、技術者派遣、JPEG、MIPI、ISP

製品開発事業

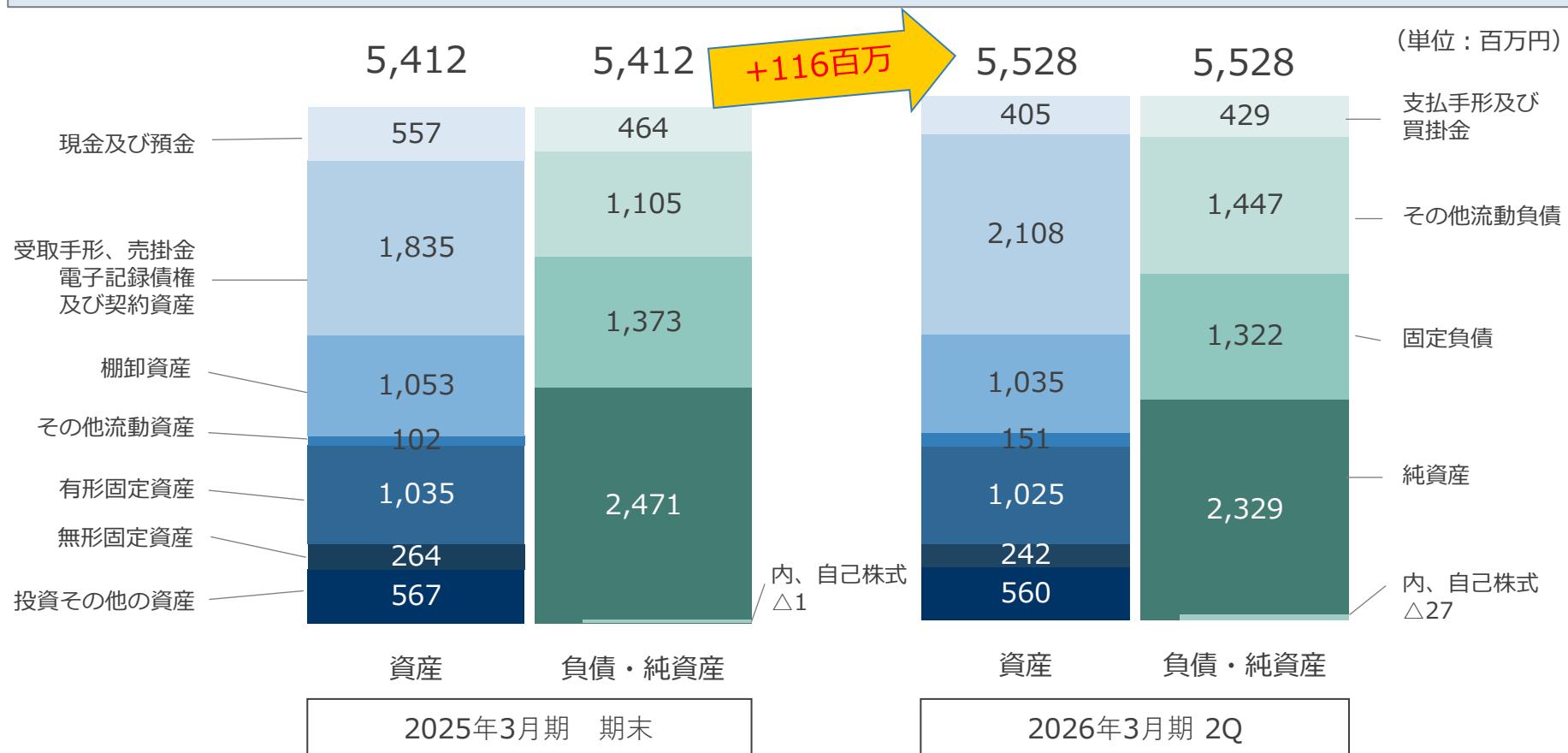
製品開発事業

画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール

【流動資産】 売掛金及び電子記録債権が131百万円減少の一方で進行基準売上高の増加により 契約資産が419百万円増加。

【流動負債】 運転資金確保のため短期借入金350百万円増加。

【純資産】 2Q期間中に自己株式の取得及び譲渡制限付株式報酬としての処分を行い、同勘定は26百万円増加、また利益剰余金も116百万円減少し、純資産は141百万円減少。自己資本比率42.1% △3.6ポイント。



2025年

4月 18日 新製品 介護施設向けミリ波レーダー・カメラ一体型**見守りシステム C-エイド**
～2025年4月より注文受付開始～

4月 24日 台湾半導体市場への拡販に向け **AGNEZ TECH INC.と協業開始**

4月 28日 パナソニック ホールディングス株式会社とライセンス契約を締結し
Nessum (IEEE1901-2020準拠) 通信モジュールを開発

5月 13日 決算発表

剰余金の配当に関するお知らせ

6月 2日 シキノハイテックと**e-con Systems**が**協業開始** 組み込みビジョンソリューションの
グローバル展開を拡大

6月 12日 決算説明会、中期経営計画

6月 24日 欧州商社 **INELTEK社と取引基本契約を締結**～欧州地域でのカメラ製品の拡販を強化～

6月 25日 第53期 定時株主総会

自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ

取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

7月 18日 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ

7月 25日 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

10月 1日 日本OSAT連合会（J-OSAT）入会のお知らせ

10月 7日 JPEG **新規格 JPEG XL のエンコーダ IP** を商品化

10月 16日 インテリLiteカメラモジュールとNessum通信モジュールを搭載した管路内の画像を
どこからでも見られるパイプカメラシステム開発

1Q

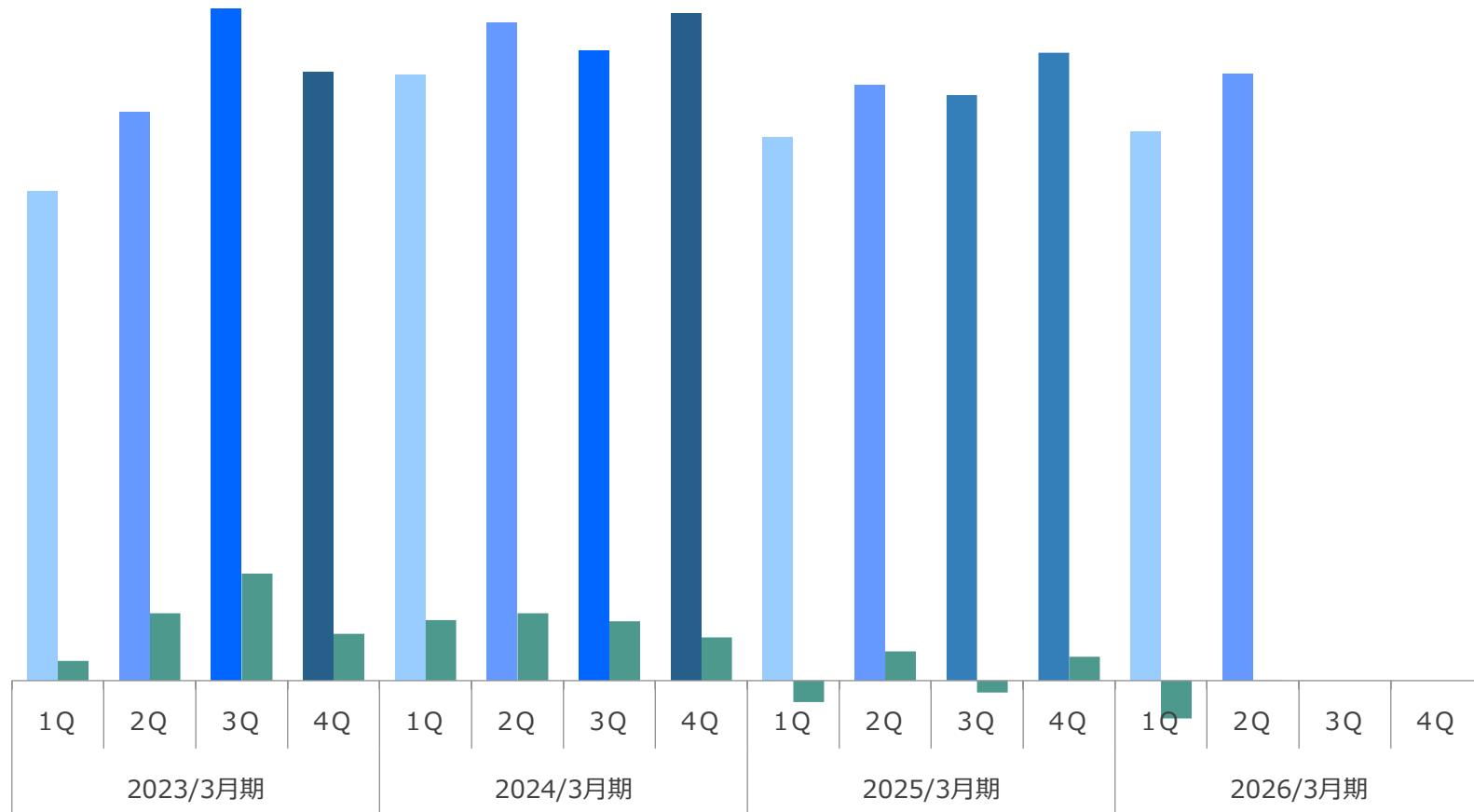
2Q

3Q

四半期業績推移

■ 1Q売上高 ■ 2Q売上高 ■ 3Q売上高 ■ 4Q売上高

■ 経常利益

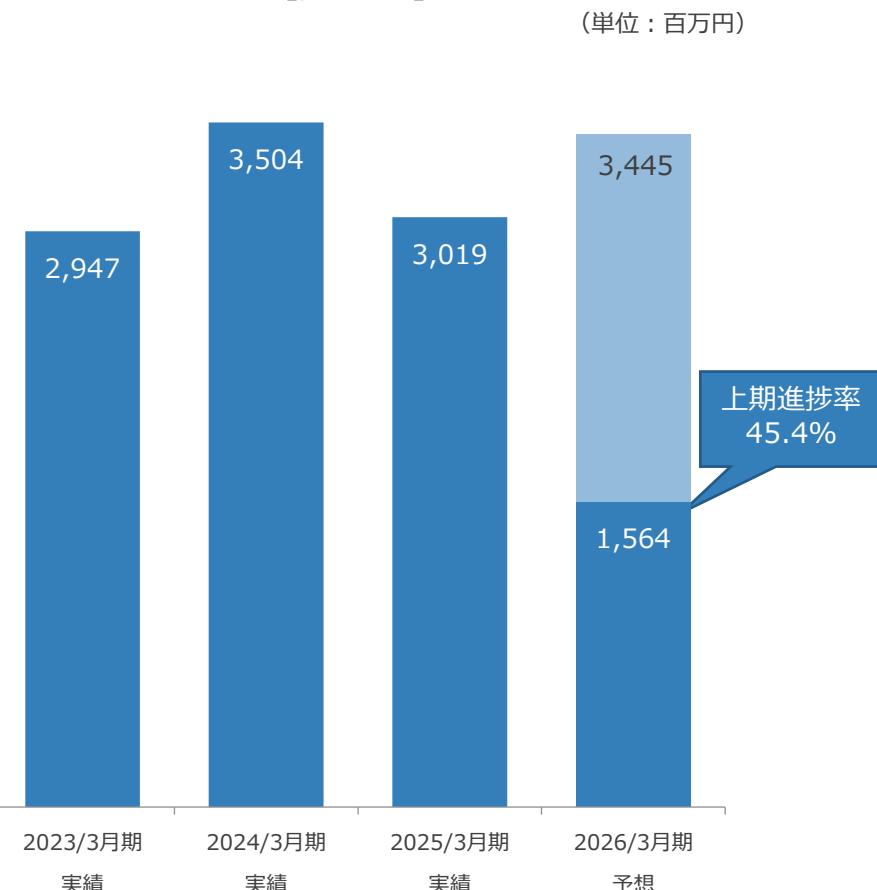


バーンインボードは、新規開拓のモジュールバーンインがサーバー系電源モジュールで増加。

カスタムバーンイン装置はサーバーや車載向け高電力のLSIに対応した新型装置開発で受注増。

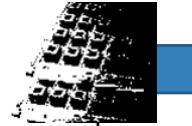
車載用専用計測機器は主要顧客の設備投資抑制が続き大幅受注減。一方、非車載向けは堅調に増加。

【売上高】



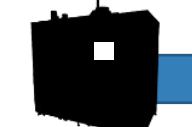
上期トピックス

➤ 半導体装置検査装置の受注がけん引



バーンインボード

前年同期比：133%



半導体検査装置販売・リース

前年同期比：214%



車載製品用専用計測機器関連

前年同期比：36%



非車載製品用 専用計測機器 関連

前年同期比：604%

Nessum製品 展示会出展

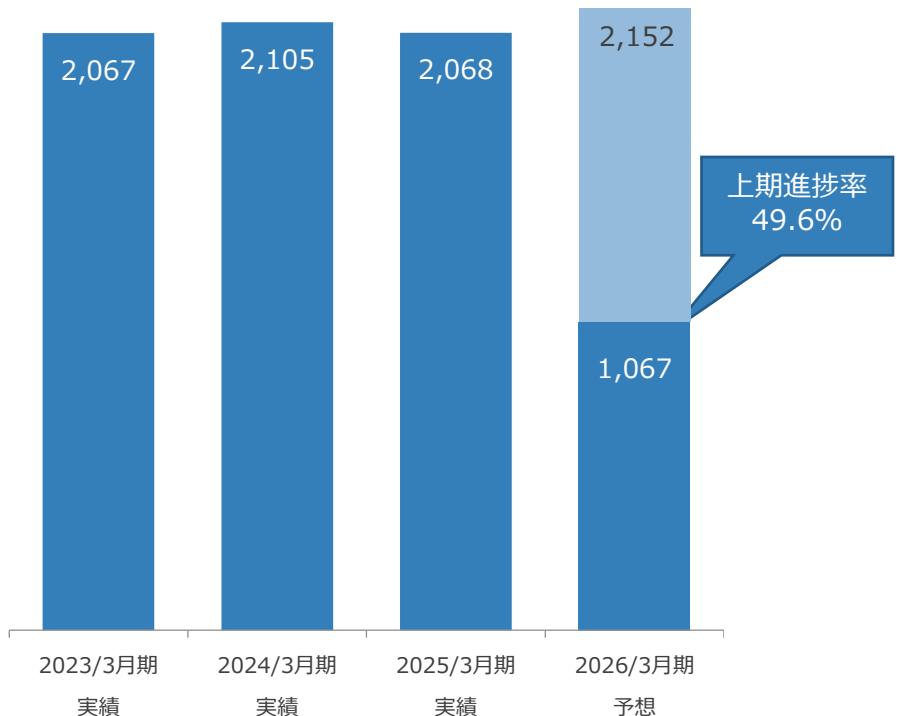
SENSOR
EXPO JAPAN
センサエキスポジャパン 2025



アナログは自動車向けパワー半導体設計が増加。モバイル向けセンサー用半導体設計も堅調。
デジタルは自動車向け設計の減少に伴い、DSC向け設計に注力。
海外比率においては、北米からのアナログ受託設計が堅調で前年比増加。

【売上高】

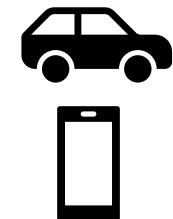
(単位：百万円)



上期トピックス

▶ アナログ半導体設計受託

自動車向け等パワー半導体
前年同期比：123%



センサー用半導体
前年同期比：112%

▶ デジタル半導体設計受託

自動車関連デジタル設計
前年同期比：83%



DSC等画像処理関連
前年同期比：111%

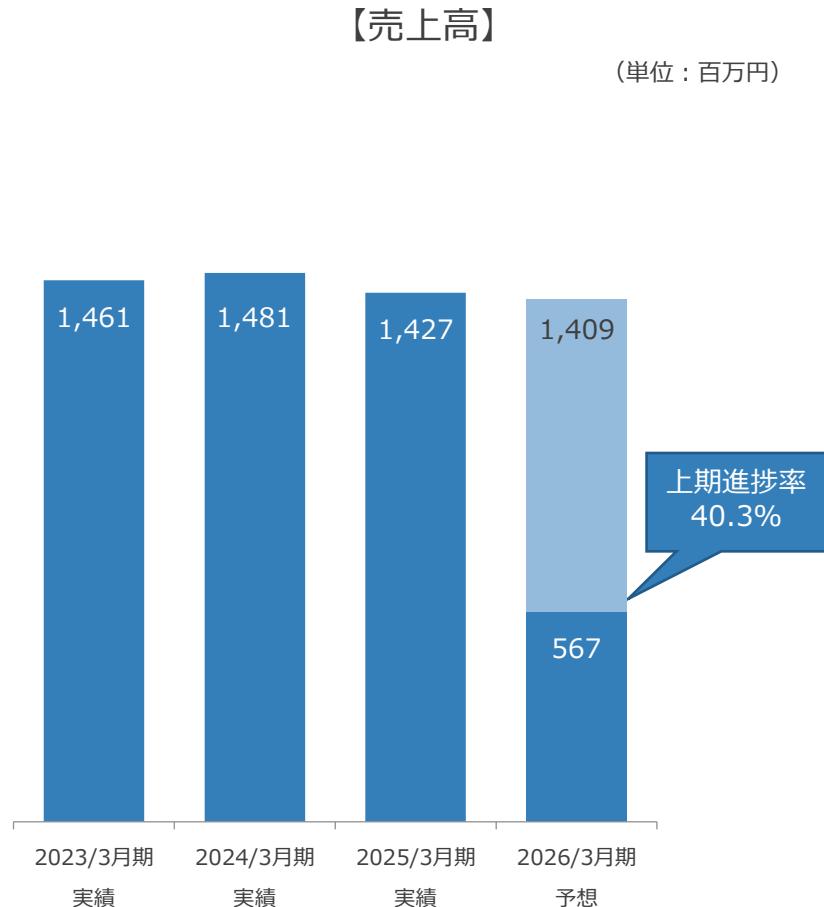


▶ 海外取引率

エンジニアリング&IP
前年同期比：174%



海外ATM、工業用検査/測定機器、産業用ドローンは堅調も、国内ATM、セルフレジ向けビューカメラの需要が減少。見守り新製品の販売を開始。



上期トピックス

- インフラ向け需要が減少、産業用途向けは堅調



産業機器向けカメラ
前年同期比:109%

インフラ用途カメラ
前年同期比:70%

- 海外企業とのパートナーシップ
 - e-con Systems社(印)と協業開始
 - INELTEK社(独)と取引基本契約締結



- 見守りシステム 「C-エイド」発売

- テクノエイド協会
 - 福祉用具情報システム(TAIS)へのコード登録
 - 介護テクノロジーの試用貸出リストへの掲載
 - 介護テクノロジー等の試用貸出事業の登録
- 製品の展示
 - とやま介護テクノロジー展
 - ひょうご福祉用具・介護ロボットフェスティバル
 - 都道府県常設展示 (富山県, 愛知県, 大阪府, 宮崎県)



C-エイド

電子システム事業： 特機向け非車載専用計測機は堅調に進捗、Nessum商品は顧客開拓中。

マイクロエレクトロニクス事業： 海外半導体の設計受託、新規IPの開発も堅調に進捗。

製品開発事業： 見守り商品を販売開始も販売進捗は遅延、海外は2社と協業を開始。

電子システム事業

<非車載専用計測 (特機分野) >

- ・新規の顧客を開拓中
- ・顧客計測器の開発・製作が順調

<Nessum>

- ・新規の顧客を開拓、提案中
- ・Nessum4Gを開発完了
- ・Nessum4Gの認証取得を完了

マイクロエレクトロニクス事業

<海外>

- ・昨年設計した顧客よりリピート案件を受注
- ・北米大手半導体ベンダーと新規取引を開始

<新IP/自社デバイス>

- ・新IPとなるJPEG-XL開発完了

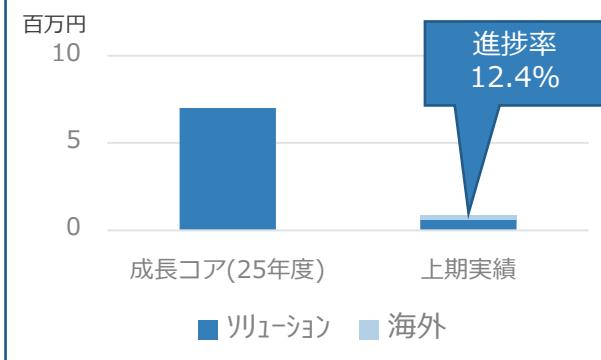
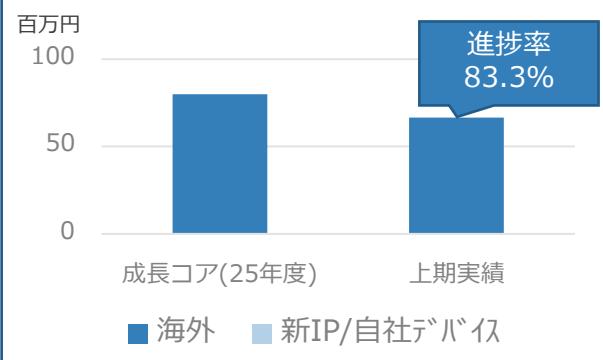
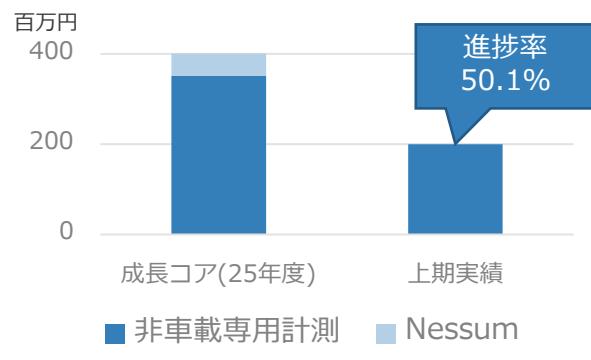
製品開発事業

<リューション>

- ・見守りシステム「C-エイド」開発完了、販売開始

<海外>

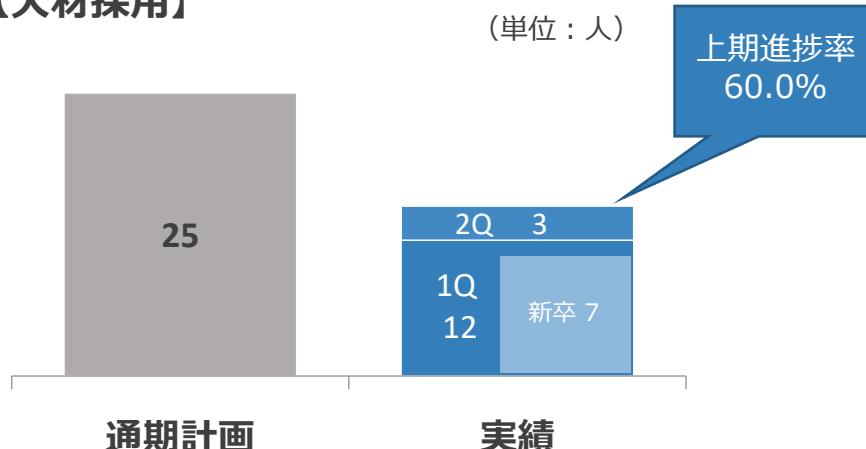
- ・e-con Systems社と製品、保有技術の相互補完を開始
- ・Ineltek社と協業し欧州産業機器メーカーと提案開始



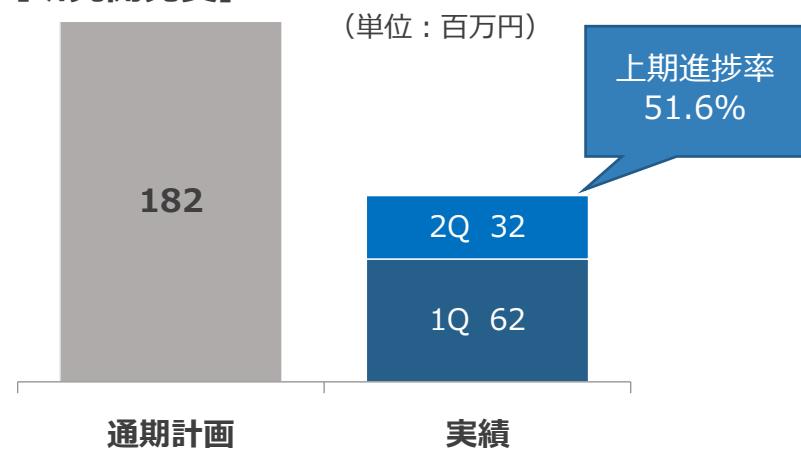
人材採用の進捗率としては順調に推移するも、人材争奪戦の激化は継続。

研究開発費は、重点テーマに注力投資し上期としてほぼ計画通りの進捗。

【人材採用】



【研究開発費】



主要開発テーマ

電子システム事業

- ・半導体検査装置・カスタム検査装置
- ・Nessum通信モジュール

マイクロエレクトロニクス事業

- ・次世代JPEG IPコア
- ・画像処理ボード

製品開発事業

- ・カメラモジュールラインナップ増強
- ・次世代エッジAIカメラシステム開発
- ・介護向け見守りシステム製品強化（機器連携ソフトウェアの開発）

本資料で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

ご注意事項

数字の処理について

当社業績に関する記載金額は特に明記が無い限り、以下の通り処理しております。そのため内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- ・表、グラフの金額：表示単位未満を切り捨て
- ・比率：表示単位第1位未満を四捨五入

お問い合わせ先

株式会社シキノハイテック

常務取締役

執行役員管理本部長 外田 敏彰

e-mail : IR-contact@shikino.co.jp

TEL : 0765-22-3477 FAX : 0765-22-3916

ホームページ : <https://www.shikino.co.jp/>